



BondSens

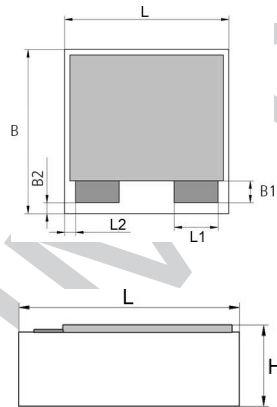
白金センサ

世界最小の白金RTDの1つ

特徴

- 非常に小型
- IEC60751に準拠した白金RTD安定性
- 非常に低ドリフト
- 金線ボンディング用に設計
- 高集積率の量産アプリケーションに最適
- LEDやハイパワーICの温度制御に最適
- 半導体デバイスと統合
- 要求に応じて特注センサーの製作可能

外観¹⁾



1) 実際のサイズは寸法を参照

技術データ

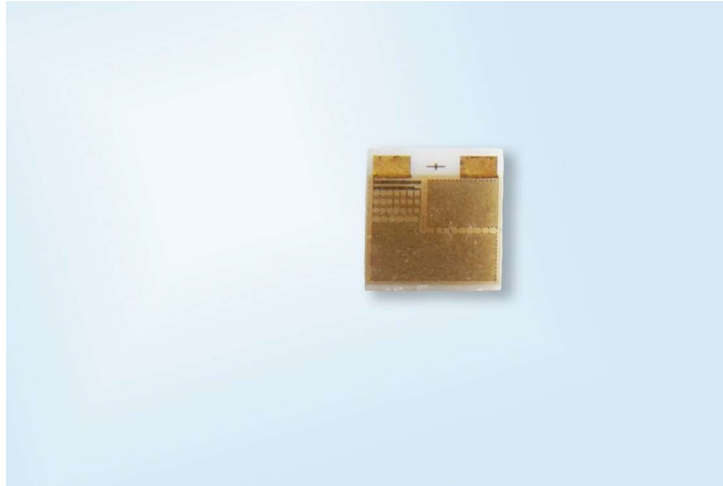
使用温度範囲:	-50 °C ~ +150 °C
公称抵抗値:*	1000 Ω at 0 °C
特性曲線:*	3850 ppm/K
長期安定性:	< 0.04 % 1000 h 130 °Cにて
許容クラス (温度範囲に依存):*	IST AG 基準
	IEC 60751 F0.3 B
接続:*	3FC 金-パッド (ボンディング)
推奨回路電流値: ²⁾	0.3 mA
特殊:	乾燥環境用のみ

2) 自己発熱に考慮する必要があります

*利用可能な顧客固有の選択肢



製品写真



ご注文情報 - 3FC (金-パッド - ボンディングパッド)

サイズ 寸法 (L / L1 / L2 x W / W1 / W2 x H in mm) F0.3 (class B)

公称抵抗値: 1000 Ω at 0 °C

0707	0.75 / 0.2 / 0.05 x 0.75 / 0.1 / 0.05 x 0.3 (±0.1)	P1K0.0707.3FC.B.T
注文番号		104316
旧注文番号		310.01424

参考資料

アプリケーションノート:	和文資料名: ATP_J
--------------	-----------------



オージー株式会社 OGG Co., Ltd. 〒 630-0247, 奈良県生駒市光陽台171
TEL 0743-74-4640 Fax 0742-90-1455 Email: infojp@ogg-co.jp Web: www.ist-ag-japan.com

All mechanical dimensions are valid at 25 °C ambient temperature, if not differently indicated • All data except the mechanical dimensions only have information purposes and are not to be understood as assured characteristics • Technical changes without previous announcement as well as mistakes reserved • The information on this data sheet was examined carefully and will be accepted as correct; No liability in case of mistakes • Load with extreme values during a longer period can affect the reliability • The material contained herein may not be reproduced, adapted, merged, translated, stored, or used without the prior written consent of the copyright owner • Typing errors and mistakes reserved • Product specifications are subject to change without notice • All rights reserved